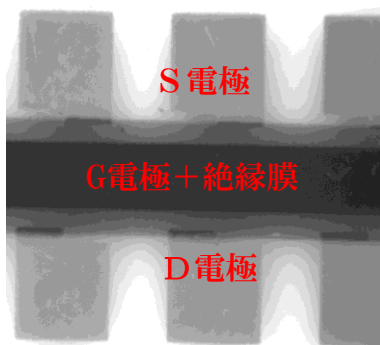
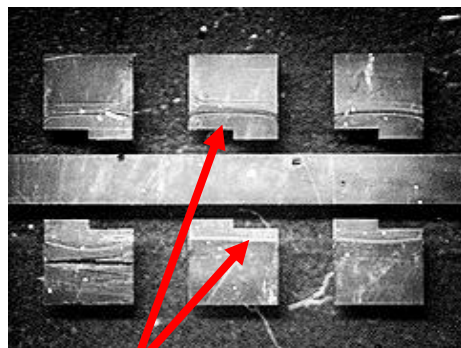


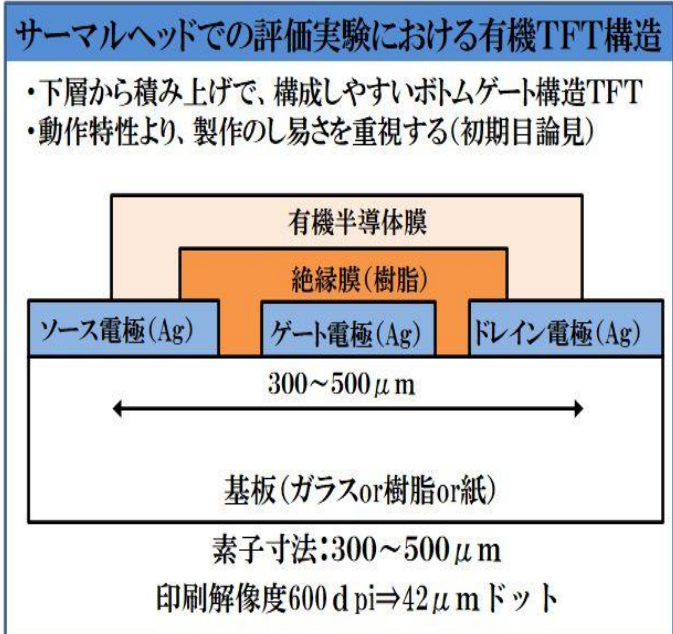
# サーマルヘッドで絶縁膜インク塗布



TFT イメージ図

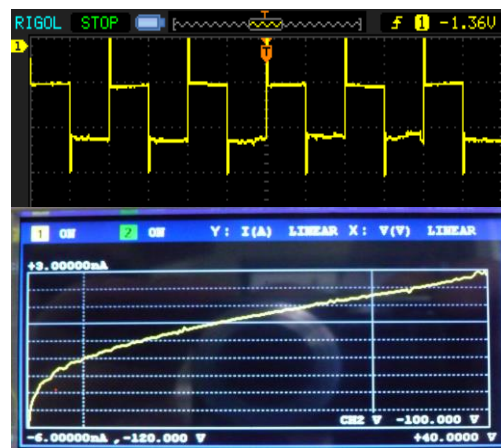


製作した絶縁膜(透明UV硬化型)  
塗布硬化後、 $\approx 100\mu\text{m}$ 厚み



ユニオンケミカ社  
UV硬化樹脂絶縁膜

メルク(株) S1200有機半導体



サーマルヘッドで有機TFT製作後の特性は、非常に悪いが、課題であった絶縁膜は出来た。  
※. 特性は有機半導体が古いためである

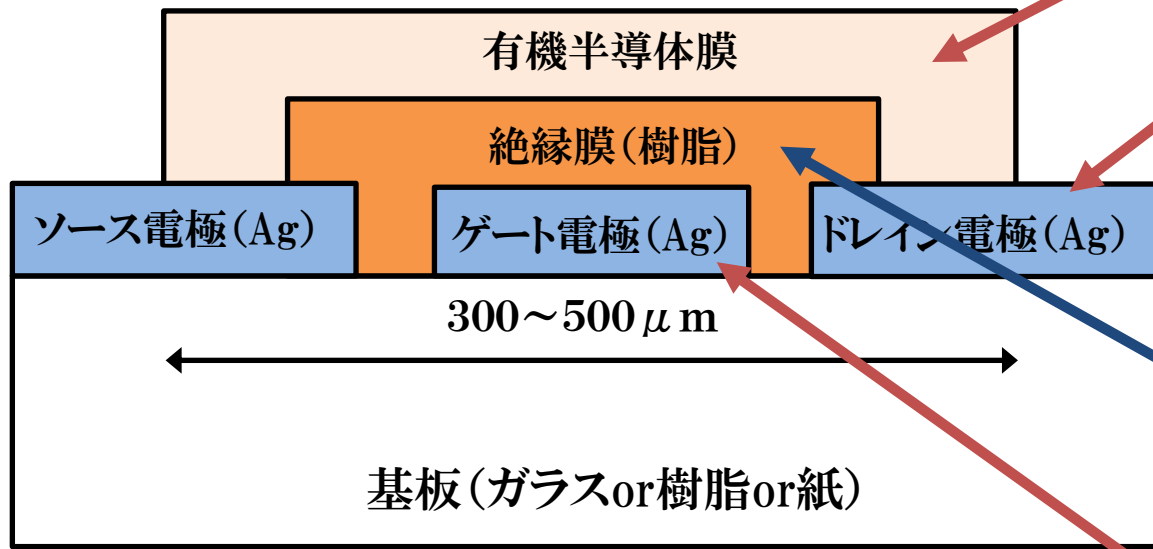
6年保存後の古い「メルク(株) S1200有機半導体」

# サーマルヘッド使用による有機TFT製作イメージ

株式会社ワイ・ドライブ

## サーマルヘッドでの評価実験における有機TFT構造

- ・下層から積み上げて、構成しやすいボトムゲート構造TFT
- ・動作特性より、製作のし易さを重視する(初期目論見)



有機半導体膜  
メルク社有機半導体

S/D電極⇒蒸着Ag膜

ユニオンケミカ社  
UV硬化樹脂・絶縁膜

G電極⇒蒸着Ag膜

素子寸法: 300~500  $\mu\text{m}$

印刷解像度 600 dpi ⇒ 42  $\mu\text{m}$  ドット